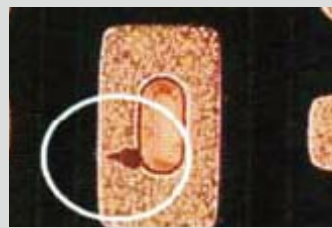


【原因・判断ポイント・発生工程】現像液劣化、現像条件の不適合などにより出来たもの（P S R現像工程）

【原因、判断要点、发生工序】由于显影液变质、显影条件不合适等所引起的（SR显影工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by a deteriorated developer or improper developing conditions (Photo solder resist development process)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率×

【Comments】
Magnification: ×

2-3-2-10 FPC 穴部 DFR 残り／FPC 孔残留 DFR / Dry film residue in an FPC hole

【特徴】F P C の穴部に D F R が残っている状態の欠陥、矢印は製品の D F R 剥離中の進行方向

【特征】在 FPC 孔残留 DFR 的缺陷，箭头指产品的 DFR 剥离方向。

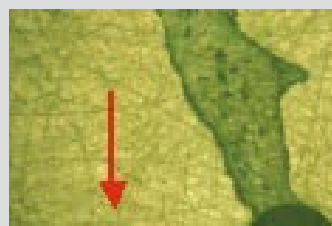
【Characteristics】Dry film residue exists in an hole of FPC. The arrow indicates the direction of the advancement of dry film stripping.

【原因・判断ポイント・発生工程】D F R 剥離液ノズルからの噴射液が十分に当たらなかったために出来たもの（F P C 回路形成後剥離工程）

【原因、判断要点、发生工序】DFR 退膜液不能充分地喷射到该部位而引起的（FPC 图形转移后的退膜工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by the insufficient spray of dry film stripper solution from a nozzle to the defective area (Dry film stripping after forming conductor pattern of FPC)



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率×

【注釋】
FPC
显微镜倍率×

【Comments】
FPC
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率×

【注釋】
FPC
显微镜倍率×

【Comments】
FPC
Magnification: ×

2-3-2-11 FPC カバーレイ下気泡残り／FPC 覆盖层存在气泡 / Bubble under FPC coverlay

【特徴】F P C のカバーレイの中に気泡が巻き込まれている状態の欠陥

【特征】FPC 覆盖层中存在气泡的缺陷。